PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-146603

(43) Date of publication of application: 07.06.1996

(51)Int.CI.

G03F 7/027 G03F 7/027 C08F220/30 C08F220/36 C08F290/06 G03F 7/004 G03F 7/028 G03F 7/033 3/06 H05K H05K 3/18

(21)Application number : **06-281840**

(22)Date of filing:

16.11.1994

(71) Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(72)Inventor: ENDO MASAKI

ICHIKAWA TATSUYA KAJIWARA TAKUYA MINAMI YOSHITAKA

(54) PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION AND PHOTOSENSITIVE ELEMENT USING SAME

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide the photosensitive resin composition reduced in an amount of sludge occurring at the time of development and enhanced in close adhesion to a substrate metal and resistance to galvanizing and tenting reliability by incorporating a binder polymer having carboxylic groups and a photopolymerization initiator and photopolymerizable compounds containing a specified compound.

CONSTITUTION: The photosensitive resin composition contains the binder polymer having carboxylic groups and the photopolymerization initiator and the photopolymerizable compounds having at least one polymerizable ethylenically unsaturated group in the molecule and composed essentially of the compound represented by formula I or II in which R is an H atom and an alkyl group; each of (m) and (n) is, independently, an integer of 1-20; and X is a group represented by formula III. An amount of sludge can be reduced and galvanization resistance, adhesion, and tenting reliability can be enhanced by using a combination of the urethane (meth)acrylate compound of formula I and the γ -

110,-03 -110, 010,-03-03, 0-11

n:=3 n:=3 a,d'e=,-

 $chloro-\beta-hydroxypropyl-\beta'-methacroyloxyethyl-o-phthalate\ compound\ of\ formula\ II.$

LEGAL STATUS

Searching PAJ Page 2 of 2

[Date of request for examination] 25.06.2001 [Date of sending the examiner's decision of 20.03.2003

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-146603

(43)公開日 平成8年(1996)6月7日

(51) Int.Cl.6	戲別記号	庁内整理番号	FΙ				技術	表示箇所
G03F 7/0	27 5 0 2							
	511							
C 0 8 F 220/3	0 MMN							
220/3	6 MMW	•						
290/0	6 MRS							
		審査請求	未請求 請求功	頁の数4	OL	(全 8]	頁) 最終	頁に続く
(21)出顧番号	特願平6-281840		(71)出顧人	000004	455		·	
				日立化	成工業	株式会社		
(22)出願日 平成6年(1994)11月16日			東京都	新宿区	西新宿2	丁目1番1·	号	
			(72)発明者	遠藤	昌樹			
				茨城県	日立市	東町四丁	目13番1号	日立化
				成工業	株式会	社山崎工力	場内	
			(72)発明者	市川	立也			
				茨城県	日立市	東町四丁	目13番1号	日立化
				成工業	株式会	社山崎工!	場内	

成工業株式会社山崎工場内 (74)代理人 弁理士 若林 邦彦

(72)発明者 梶原 卓哉

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 感光性樹脂組成物及びこれを用いた感光性エレメント

(57)【要約】

【目的】 現像時に発生するスラッジを低減し、銅スル ーホール法、ハンダスルーホール法いずれの方法によっ ても、耐めっき性、下地金属との密着性等に優れ、かつ テント信頼性が良好な感光性樹脂組成物及びこれを用い た感光性エレメントを提供する。

(A) カルボキシル基を有するバインダーポ リマ、(B) 光重合開始剤及び(C) 分子内に少なくと も一つの重合可能なエチレン性不飽和基を有する光重合 性化合物を含み、前記(C)成分に一般式(I) 【化1】

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化

(式中、Rは水素原子又はアルキル基を示し、m及びn は各々独立に1~20の整数であり、Xは

【化2】

で表される化合物を必須成分として含有する感光性樹脂 組成物及びこれを用いた感光性エレメント。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) カルボキシル基を有するバインダーポリマ、(B) 光重合開始剤及び(C) 分子内に少な

くとも一つの重合可能なエチレン性不飽和基を有する光 重合性化合物を含み、前記(C)成分に一般式(I) 【化1】

$$CH_2 = C - CH_3$$
 $CH_2 = C - CH_3$ $CH_3 = C - CH_4$ $CH_4 = C - CH_5$ $CH_5 = C - CH_6$ $CH_6 = C$

$$H_3 C$$
 $H_3 C C H_2 O C H_3$
 $C - O - C H_2 - C H_2 - O - C - C H = C H_2$
 $C - O - C H_2 - C H - C H_2 - C I$

(II)

で表される化合物を必須成分として含有する感光性樹脂組成物。

【請求項2】 (C) 成分中の一般式(I) で表される 化合物の含有量が、(C) 成分100重量部に対して10~90重量部である請求項1記載の感光性樹脂組成物。

【請求項3】 (A)成分、(B)成分及び(C)成分の使用割合が、(A)40~80重量部、(B)0.1~20重量部及び(C)20~60重量部(但し(A)成分及び(C)成分の合計量を100重量部とする)である請求項1、2又は3記載の感光性樹脂組成物。

【請求項4】 請求項1、2又は3記載の感光性樹脂組成物を支持体上に塗布、乾燥した感光性エレメント。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は感光性樹脂組成物及びこれを用いた感光性エレメントに関する。

[0002]

【従来の技術】従来、印刷配線板の製造法にはテンティング法とめっき法の二つがある。テンティング法は、チップ搭載のための銅スルーホールをレジストで保護し、エッチング、レジスト剥離を経て、電気回路形成を行う方法である。一方、めっき法は、電気めっきによってスルーホールに銅を析出させ、半田めっきで保護し、レジスト剥離、エッチングによって電気回路の形成を行う方法である。これらの方法を実施するときに、レジストとして感光性樹脂組成物及びこれを用いた感光性エレメントが使用されており、未硬化部をアルカリ性水溶液で除

去するアルカリ現像形が主流となっている。

【0003】しかし、アルカリ現像型の感光性樹脂組成 物を用いた場合は、現像液中に未重合の感光性樹脂組成 物が溶解し、この溶解成分がスラッジとなり、基板上に 再付着してショート不良の発生原因となっている。特 に、現像時の発泡を抑制する消泡剤を組み合わせて使用 することにより、スラッジ発生量が多くなるという問題 があるため、従来の感光性樹脂組成物及び感光性エレメ ントは、スラッジ発生によるショート不良防止のため に、現像機の洗浄を短期間で行い、さらに循環ポンプに 使用しているフィルタの交換も短期間で行わなければな らず、改善が求められていた。また、特公平4-396 61号公報には、界面活性剤を含有することを特徴とす る光重合性組成物が開示されているが、これは現像機の ポリ塩化ビニル樹脂部分の軟化、膨潤の防止を主目的と しており、現像時に発生するスラッジについての記載は ない。

【0004】さらに、近年印刷配線板の配線の高密度化、高精度化に伴い、テンティング法では、スルーホールの異形穴化、スルーホールランドの狭小化等に対するテント信頼性が問題となっており、また、めっき法では、めっき薬品に対する耐性が要求されるが、従来の技術ではこの耐性を増すと、硬化した膜が硬くてもろくなるため、テント信頼性との両立が難しく、問題となっていた。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記した従 来技術の問題点を解決し、現像時に発生するスラッジを 低減し、銅スルーホール法、ハンダスルーホール法いず れの方法によっても、耐めっき性、下地金属との密着性 等に優れ、かつテント信頼性が良好な感光性樹脂組成物 及びこれを用いた感光性エレメントを提供するものであ る。

[0006]

【化6】

(式中、Rは水素原子又はアルギル基を示し、m及びn は各々独立に1~20の整数であり、Xは

【化5】

$$H_3 C$$
 $H_3 C C H_2 O C H_3$
 $C - O - C H_2 - C H_2 - O - C - C H = C H_2$
 $C - O - C H_2 - C H - C H_2 - C I$
 $O C H_3$
 $O C H_3$

で表される化合物を必須成分として含有する感光性樹脂組成物及びこれを用いた感光性エレメントに関する。

【0007】低スラッジ化、耐めっき性、密着性及びテント信頼性の向上は、上記一般式(I) で表される化合物(ウレタン(メタ)アクリレート)と式(II)で表される化合物(γ -クロロー β -ヒドロキシプロピルー β '-メタクリルロイルオキシエチルー α -フタレート)とを組み合わせて用いることにより達成される。

【0008】特願平5-271129号公報において、 耐めっき性と密着性の向上は、上記一般式 (I) で表される化合物のXが、

【化7】

$$\begin{array}{cccc} -\left(C\,H_{2}\right)_{n} & \text{Z} & \text{Z} \\ -C\,H_{2} - & & C\,H_{3} & \\ -C\,H_{2} - & C\,H_{2} - C\,H_{2} - C\,H_{2} - C\,H_{2} - \\ & & C\,H_{3} \end{array}$$

(式中、nは1~20の整数である)で表される化合物及び式(II)で表される化合物を必須成分として含有する感光性樹脂組成物及びこれを用いた感光性エレメントで達成される。また、その後の調査、検討により低スラッジ化も図れることが判明した。しかし、この組合せではテント信頼性があまり良好ではなかった。また、上記一般式(I)で表される化合物のXが、

【化8】

【課題を解決するための手段】本発明は、(A) カルボ

キシル基を有するパインダーポリマ、(B) 光重合開始

剤及び(C)分子内に少なくとも一つの重合可能なエチ

(式中、nは $1\sim20$ の整数である)の場合、上記一般式 (I)で表される化合物は、常温では固化してしまい取り扱いが非常に困難であった。しかし、上記一般式

(I)で表される化合物のXを

【化9】

にすると、常温では溶融した状態となり、取り扱いが非常に容易になり、低スラッジ化、耐めっき性、密着性及びテント信頼性を向上することができる。

【0009】以下、本発明について詳述する。本発明に (A) 成分として用いられるカルボキシル基を有するバインダポリマとしては、例えば、(メタ) アクリル酸アルキルエステル((メタ) アクリル酸とはメタクリル酸及びアクリル酸を意味する。以下同じ)と(メタ) アク リル酸とこれらと共重合しうるビニルモノマーとの共重 合体等が挙げられる。これらの共重合体は、単独で又は 2種類以上を組み合わせて使用される。

【0010】(メタ) アクリル酸アルキルエステルとしては、例えば、(メタ) アクリル酸メチルエステル、

(メタ) アクリル酸エチルエステル、(メタ) アクリル酸ブチルエステル、(メタ) アクリル酸 2-エチルへキシルエステル等が挙げられる。また、(メタ) アクリル酸アルキルエステルや(メタ) アクリル酸と共重合しうるビニルモノマとしては、例えば、(メタ) アクリル酸デトラヒドロフルフリルエステル、(メタ) アクリル酸ジメチルアミノエチルエステル、(メタ) アクリル酸ジメチルアミノエチルエステル、メタクリル酸グリシジルエステル、2,2,2-トリフルオロエチル(メタ) アクリレート、2,2,3,3-テトラフルオロプロピル(メタ) アクリレート、2,2,3,3-テトラフルオロプロピル(メタ) アクリレートアクリルアミド、ジアセトンアクリルアミド、スチレン、ビニルトルエン等が挙げられる。

【0011】本発明に(B)成分として用いられる光重 合開始剤としては、例えば、ベンゾフェノン、N, N' ーテトラメチルー4, 4' ージアミノベンゾフェノン 4' -ジアミノベンゾフェノン、4-メトキシー4' -ジメチルアミノベンソフェノン、2-エチルアントラキ ノン、フェナントレンキノン等の芳香族ケトン、ベンゾ インメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベン ゾインフェニルエーテル等のベンゾインエーテル、メチ ルベンゾイン、エチルベンゾイン等のベンゾイン、ベン ジルジメチルケタール等のベンジル誘導体、2-(o-クロロフェニル) -4, 5-ジフェニルイミダゾールニ 量体、2-(o-クロロフェニル)-4,5-ジ(m-メトキシフェニル) イミダゾール二量体、2- (o-フ ルオロフェニル) -4, 5-ジフェニルイミダゾールニ 量体、2-(o-メトキシフェニル)-4,5-ジフェ ニルイミダゾール二量体、2-(p-メトキシフェニ ル) -4, 5-ジフェニルイミダゾール二量体、2, 4 ージ (pーメトキシフェニル) ー 5 ーフェニルイミダゾ ール二量体、2-(2,4-ジメトキシフェニル)-4, 5-ジフェニルイミダゾール二量体、2-(p-メ チルメルカプトフェニル) -4, 5-ジフェニルイミダ ゾール二量体等の2,4,5-トリアリールイミダゾー ル二量体、9-フェニルアクリジン、1, 7-ビス (9, 9'-アクリジニル) ヘプタン等のアクリジン誘 導体などが挙げられる。これらは単独で又は2種類以上 を組み合わせて使用される。

【0012】また、成分(C)中の、必須成分である一般式(I)で表される化合物及び式(II)で表される化合物以外のものとしては、例えば、ポリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート(エチレン基の数が2~14のもの)、トリメチロールプロパンジ(メタ)アクリ

レート、トリメチロールプロパントリ (メタ) アクリレ ート、テトラメチロールメタントリ (メタ) アクリレー ト、テトラメチロールメタンテトラ (メタ) アクリレー ト、ポリプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート (プロピレン基の数が2~14のもの)、ジペンタエリ スリトールペンタ (メタ) アクリレート、ジペンタエリ スリトールヘキサ (メタ) アクリレート等の多価アルコ ールに α 、 β -不飽和カルボン酸を反応させて得られる 化合物、ビスフェノールAジオキシエチレンジ (メタ) アクリレート、ビスフェノールAトリオキシエチレンジ (メタ) アクリレート、ビスフェノールAデカオキシエ チレンジ (メタ) アクリレート等のビスフェノールAジ オキシエチレンジ (メタ) アクリレート、トリメチロー ルプロパントリグリシジルエーテルトリアクリレート、 ビスフェノールAジグリシジルエーテルアクリレート等 のグリシジル基含有化合物に α 、 β -不飽和カルボン酸 を付加して得られる化合物、 (メタ) アクリル酸メチル エステル、(メタ) アクリル酸エチルエステル、(メ タ) アクリル酸プチルエステル、(メタ) アクリル酸2 -エチルヘキシルエステル等の(メタ)アクリル酸のア ルキルエステルなどが挙げられる。

【0013】本発明において、(A)成分の配合量は、(A)成分及び(C)成分の総量100重量部に対して、40~80重量部の範囲とすることが好ましい。この配合量が40重量部未満では、光硬化物が脆くなり易い傾向があり、感光性エレメントとして用いた場合、塗膜性に劣る傾向がある。また、この配合量が80重量部を超えると、感度が不充分となる傾向がある。

【0014】(B)成分の配合量は、(A)成分及び(C)成分の総量100重量部に対して、0.1~20重量部の範囲とすることが好ましい。この配合量が0.1重量部未満では、感度が不充分となる傾向があり、20重量部を超えると、露光の際に組成物の表面での吸収が増大して、内部の光硬化が不充分となる傾向がある。【0015】また、(C)成分の配合量は、(A)成分及び(C)成分の総量100重量部に対して、20~60重量部の範囲とすることが好ましい。この配合量が20重量部未満では、感度が不充分となる傾向があり、60重量部を超えると、光硬化物が脆くなる傾向がある。【0016】(C)成分中の必須成分である一般式

(I)で表される化合物の配合量は、(C)成分100 重量部に対して、10~90重量部であることが好まし く、60~90重量部であることがより好ましい。この 配合量が10重量部未満では、耐めっき性、密着性及び テント信頼性が劣る傾向があり、90重量部を超える と、スラッジ量が増える傾向がある。なお、一般式

(I) におけるm及Vnは、各々独立に $1 \sim 20$ の整数 とされる。

【0017】また、(C)成分中の必須成分である式 (II)で表される化合物の配合量は、(C)成分100 重量部に対して、10~90重量部であることが好ましく、10~40重量部であることがより好ましい。この配合量が10重量部未満では、耐めっき性、密着性及びテント信頼性が劣る傾向があり、90重量部を超えると、スラッジ量が増える傾向がある。

【0018】本発明の感光性樹脂組成物には、染料、発色剤、可塑剤、顔料、難燃剤、安定剤、密着性付与剤等の添加剤を必要に応じて添加してもよい。

【0019】本発明の感光性樹脂組成物は、前記各成分を、これらを溶解する溶剤、例えば、トルエン、アセトン、メチルエチルケトン(MEK)、メチルイソブチルケトン、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、クロロホルム、塩化メチレン、ジメチルホルムアミド、メタノール、エタノール等に溶解することにより、均一な溶液とできる。

【0020】本発明の感光性樹脂組成物は、これを支持体上に塗布、乾燥し、感光性エレメントとして使用することもできる。支持体としては、重合体フィルム、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン、ポリエチレン等からなるフィルムが用いられ、中でもおり、エチレンテレフタレートフィルムが好ましい。これらの重合体フィルムは、後に感光層から除去可能でなくてはならないため、除去が不可能となるような表面処理が施されたものであったり、材質であったりしてはならない。また、これらの重合体フィルムの厚さは、5~100μmとすることが好ましく、10~30μmとすることが好ましく、10~30μmとすることが好まして、他の一つは感光層の保護フィルムとして感光層の両面に積層してもよい。

【0021】本発明の感光性エレメントを用いてフォトレジスト画像を製造するに際しては、前記の保護フィルムが存在している場合には、保護フィルムを除去後、感光層を加熱しながら基板に圧着させることにより積層する。積層される表面は、通常、金属面であるが、特に制限はない。感光層の加熱圧着の温度は、特に制限はないが、通常、90~130℃とされる。また、感光層の加熱圧着の圧力は、特に制限はないが、通常、3kg/cm²とされる。感光層を前記のように加熱すれば、予め基板を予熱処理することは必要でないが、積層性をさらに向上させるために基板の予熱処理を行うこともできる。

【0022】このようにして積層が完了した感光層は、 次いで、ネガフィルム又はポジフィルムを用いて活性光 により画像的に露光される。この際、感光層上に存在す る重合体フィルムが透明の場合には、そのまま露光して もよく、また、不透明の場合には、除去する必要があ る。感光層の保護という点からは、重合体フィルムは透明で、この重合体フィルムを残存させたまま、それを通 して露光することが好ましい。

【0023】活性光は、公知の活性光源、例えば、カーボンアーク、水銀蒸気アーク、キセノンアーク等から発生する光が用いられる。感光層に含まれる光重合開始剤の感受性は、通常、紫外線領域において最大であるので、その場合は活性光源は紫外線を有効に放射するものにすべきである。光重合開始剤が可視光線に感受するもの、例えば、9,10-フェナンスレンキノン等である場合には、活性光としては可視光が用いられ、その光源としては前記のもの以外に写真用フラッド電球、太陽ランプ等も用いられる。

【0024】次いで、露光後、感光層上に重合体フィル ム等が存在している場合には、これを除去した後、アル カリ水溶液を用いて、例えば、スプレー、揺動浸漬、ブ ラッシング、スクラッピング等の公知方法により未露光 部を除去して現像する。アルカリ性水溶液の塩基として は、例えば、リチウムの水酸化物、ナトリウムの水酸化 物、カリウムの水酸化物等の水酸化アルカリ、リチウム の炭酸塩又は重炭酸塩、ナトリウムの炭酸塩又は重炭酸 塩、カリウムの炭酸塩又は重炭酸塩等の炭酸アルカリ、 リン酸カリウム、リン酸ナトリウム等のアルカリ金属リ ン酸塩、ピロリン酸ナトリウム、ピロリン酸カリウム等 のアルカリ金属ピロリン酸塩などが用いられ、特に、炭 酸ナトリウムが好ましい。現像に用いるアルカリ水溶液 のpHは、9~11とすることが好ましく、また、その温 度は、感光層の現像性に合わせて調節される。また、ア ルカリ水溶液中には、表面活性剤、消泡剤、現像を促進 させるための少量の有機溶剤等を混入させてもよい。

【0025】さらに、印刷配線板を製造するに際しては、現像されたフォトレジスト画像をマスクとして露光している基板の表面を、エッチング、めっき等の公知方法で処理する。次いで、フォトレジスト画像は、通常、現像に用いたアルカリ水溶液よりさらに強アルカリ性の水溶液で剥離される。この強アルカリ性の水溶液としては、例えば、1~5重量%の水酸化ナトリウム水溶液等が用いられる。

[0026]

【実施例】次に、本発明を実施例により説明する。 実施例1及び比較例1~7

表1に示す材料 ((A)成分、(B)成分、添加剤及び溶剤) を配合し、溶液を得た。

【表1】

	材料	配合量
(A) 成 分	メタクワル酸/メタクワル酸メチル/アクリル酸エチル/メタクワル酸ェチル(22/45/27/6(重量比)、重量平均分子量100,000)の40重量% メチルセロソルプ/トルエン(6/4(重量比))溶液	150g (固形分60g)
(B) 成分	2-(o-クロロフェニル)-4,5-ジフェニルイミダゾール二量体	3.0g
27	N,N'-テトラエチル-4,4'-ジアミノベンゾフェノン	0.2g
添	ロイコクリスタルバイオレット	0.5g
加	マラカイトグリーン	0.05g
剤	pートルエンスルホン酸アミド	4.0g
溶	メチルエチルケトン	10g
f f	トルエン	10g
剤	メタノール	3 g
	ジメチルホルムアミド	3.0g

【0027】この溶液に表2に示す(C)成分を溶解さ 【表 2 】

せて感光性樹脂組成物の溶液を得た。

表 2

		実施例			比	較	例		
		1	1	2	3	4	5	6	7
	UA-11P -1	30	40	_	_	_		_	_
(C)	UA-11 -2	-	_	40	30	_	_	-	_
成	BPE-10 *3	-	-	_	_	40	30	_	_
分	APG-400 -4	_	_	_	_	_	-	40	30
	MECHPP *5	10	_	_	10	_	10	_	10

【0028】*1 一般式表中の数値はH 固形分の重量(署)を表す。5μm厚のポリエチレンテレフタレートフィルム上に均 5 、 X = 【化10】

*2 一般式(I)でR=H、m=5、n=5、X= 【化11】

$$+(CH_2)-$$

の化合物(新中村化学社製)。

*3 ビスフェノールAポリオキシジメタクリレート(新 中村化学社製)。

*4 テトラプロピレングリコールジアクリレート (新中 村化学社製)。

*5 一般式(II)で表される化合物でγ-クロローβ-ヒドロキシプロピルーβ′ーメタクリルロイルオキシエ チルーo-フタレート (大阪有機化学工業社製)。

【0029】次いで、この感光性樹脂組成物の溶液を2

一に塗布し、100℃の熱風対流式乾燥機で10分間乾 燥して感光性エレメントを得た。感光性樹脂組成物層の 乾燥後の膜厚は、50μmであった。

【0030】一方、銀箔(厚さ35 μm)を両面に積層 したガラスエポキシ材である銅張り積層板(日立化成工 業社製、商品名MCL-E-61)の銅表面を#600 相当のブラシを持つ研磨機(三啓社製)を用いて研磨 し、水洗後、空気流で乾燥し、得られた銅張り積層板を 80℃に加温し、その銅表面上に前記感光性樹脂組成物 層を120℃に加熱しながらラミネートした。次いで、 このようにして得られた基板に、ネガフィルムを使用 し、3kW高圧水銀灯(オーク製作所社製、HMW-20 1B) で90mJ/cm²の露光を行った。

【0031】次いで、ポリエチレンテレフタレートフィ ルムを除去し、30℃で1重量%炭酸ナトリウム水溶液 1リットルを60秒間スプレーすることにより、未露光 部分を除去した。この現像工程において、発生したスラ ッジを遠心分離機により分離、濾過し、さらに150℃ で4時間乾燥した後、スラッジの重量を測定した。

【0032】また、密着性は、現像液にはく離せずに残 ったラインの幅(µm)で表され、この密着性の数値が 小さい程、細いラインでも銅張り積層板からはく離せず に銅張り積層板に密着していることから、密着性が高い ことを示す。

【0033】耐メッキ性は、上記のようにラミネート し、所定の露光量の露光を行った。次いで上記現像液に より現像後、脱脂 (PC-455(メルテックス社製)2 5重量%)5分浸漬→水洗→ソフトエッチ(過硫酸アン モニウム150g/リットル) 2分浸漬→水洗→10重量%硫 酸1分浸漬の順に前処理を行い、硫酸銅メッキ浴(硫酸 銅75g/リットル、硫酸190g/リットル、塩素イオン50pp m、カパーグリームPCM(メルテックス社製) 5 ml/リット ル) に入れ、硫酸銅メッキを室温下、3A/dm²で40分間 行った。その後、水洗して10重量%ホウフッ化水素酸 に1分浸漬し、ハンダメッキ浴(45重量%ホウフッ化 スズ64ml/リットル、45%ホウフッ化鉛22ml/リットル、4 2重量%ホウフッ化水素酸200ml/リットル、プルティン LAコンダクティビティーソルト(メルテックス社製)2 Og/リットル、プルティンLAスターター(メルテックス社 製)40ml/リットル) に入れ、半田メッキを室温下、1.5 A/dm²で15分間行った。

【0034】水洗、乾燥後耐メッキ性を調べるため直ちにセロテープを貼り、これを垂直方向に引き剥がして(90°ピールオーフ試験)、レジストの剥がれの有無を見た。また、レジスト剥離後上方から光学顕微鏡で半

田メッキのもぐりの有無を観察した。半田メッキのもぐりを生じた場合、透明なレジストを介してその下部にめっきにより析出した半田が観察される。

【0035】次に、1.6mm厚の銅張積層板に直径6mmの穴を100個あけた基材に感光性樹脂組成物の積層体を両面に積層し、90mJ/cm²の露光を行い、60秒間現像した。次にこの穴の強度を直径1.5mmの挿入径の円柱を用いてレオメーター(FUDOH社製)により破断までの強度と伸びを測定した。

【0036】また、1.6mm厚の銅張り積層板に直径4mmの穴が3個連なって空いてある基材(図1参照)に感光性樹脂組成物の積層体を両面に積層し、90mJ/cm²の露光を行い、60秒間の現像を2回行った。そして現像後、図1の1に示した箇所(合計18個の3連φ4mm穴)の穴破れ数を測定し、異形テント破れ率(下記数式)として評価した。

【数1】

[0038]

【表3】

赛 3

		実施例 1	比較例1	比較例2	比較例3	比較例4	比較例5	比較例6	比較例7
スラッジ量 (g/リットル)		0.02	0.08	0.08	0.02	0.31	0.20	0.25	0.14
密 着	性 (µm)	3 5	40	4 0	3 5	4.5	4 0	4 5	4 0
耐めっき性	テープテスト (はがれ)	なし	あり	あり	なし	なし	なし	あり	あり
	めっきもぐり	なし	あり	あり	なし	なし	なし	あり	なし
テント	強度(g)	550	450	450	450	550	500	500	450
テント	伸 び(mm)	1. 2	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1. 2	1.0
異形テント	ト破れ率 (%)	1	0	5	10	0	1	1	2

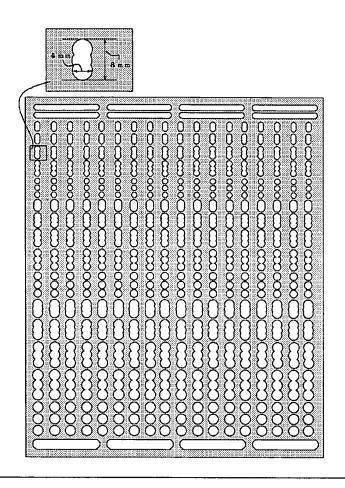
【0039】以上の結果から明らかなように、一般式 (I) で表される(ウレタン(メタ)アクリレート)と式 (II) で表される化合物(γ - クロロー β - ヒドロキシプロピルー β' - メタクリルロイルオキシエチルー α - フタレート)とを組み合わせて用いることにより、現像時に発生するスラッジを低減し、密着性に優れ、耐めっき性及びテント信頼性を向上させることができる。

[0040]

【発明の効果】本発明の感光性樹脂組成物及びこれを用いた感光性エレメントは、現像時に発生するスラッジを 低減し、下地金属への密着性、耐めっき性及びテント信頼性に優れたものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例で異形テント破れ率を評価した評価基板である。なお、異形テント破れ率を評価した箇所の18個のうち、1箇所を拡大して示した。



フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G03F	7/004	5 1 2			
	7/028				
	7/033				
H05K	3/06	J			
		H			
	3/18	D	7511-4E		

(72)発明者 南 好隆

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化 成工業株式会社山崎工場内